

# Telsonic 惊艳亮相装配展 (The Assembly Show)

2016 年 11 月



第 4 届装配展于 2016 年 10 月 25 - 27 日在伊利诺伊州罗斯蒙特举办。共有 276 家展商前来参展，占据了唐纳德 E 斯蒂芬斯会议中心 67,000 平方英尺的展览空间。出席人数超过 70,000。

在今年的展会上，Telsonic 大获成功。其中的亮点之一就是新增的机器制造商展示环节。Telsonic 展示了用于与 Telsonic 新款 [MAG](#) 超声波发生器通信，以及使用配电箱模拟 PLC 离散 I/O 的多种方式。此外，还展示了具有可选 I/O 块（用于连接辅助设备）的 [TCS5](#) 控制器。Telsonic 在展会现场演示对荧光笔进行焊接，让展会参观者亲眼见证了应用示例。

作者：美国密歇根州 Telsonic Ultrasonics Inc. 销售工程师 Lizzy Schindler